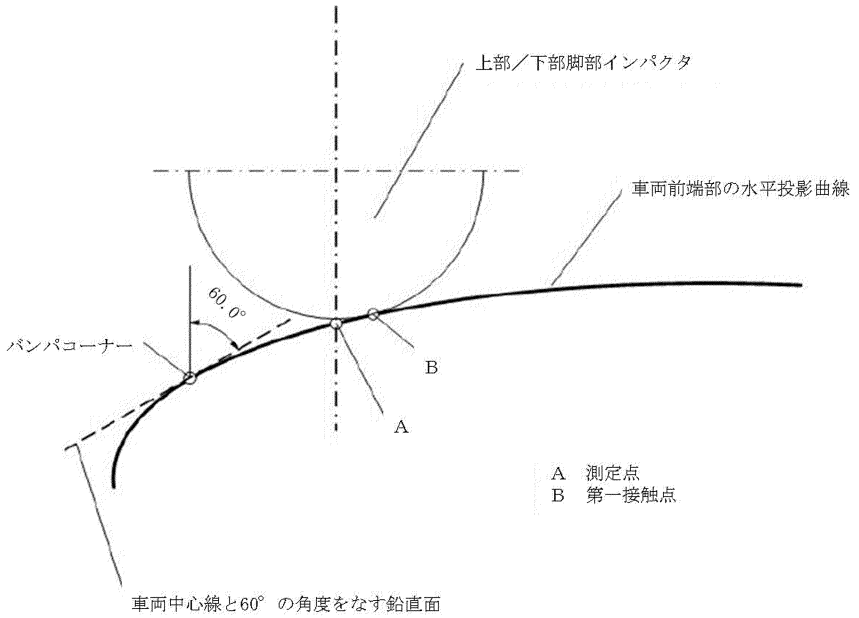
図５Ｃ　脚部インパクタ試験における測定点及び第一接触点（車両上面図）



2.12.　「頭部傷害基準（以下､「ＨＩＣ」という。)」とは、頭部傷害の程度を示す指数であり、頭部インパクタで計測された加速度を用い次の計算式によって計算された値の最大値をいう。

$$HIC=\left\{\frac{1}{(t_2-t_1)}\int_{t_1}^{t_2}\frac{a}{9.81}dt\right\}^{2.5}(t_2-t_1)_{max}$$

ａ：合成加速度（m／s^2）　ｔ：時間(s)　$t_2-t_1 \leqq 15$ms

2.13.　「子供頭部インパクタ前面基準線」とは、車両前部上面のＷＡＤが1,000㎜の点の集合線をいう。ただし、ボンネット・リーディング・エッジ基準線のいずれの点においても､ＷＡＤが1,000㎜超となる場合には、子供頭部インパクタ前面基準線は、ボンネット・リーディング・エッジ基準線とするものとする。

2.14.　「子供頭部インパクタ試験領域」とは、車両前部上面であり、次の境界で囲まれた領域をいう。なお、82.5㎜の距離はフレキシブルテープを車両外面に沿って緩みのない状態で特定するものとする。

(a)　前方は、ＷＡＤが1,000㎜の点の集合線又はボンネット・リーディング・エッジ基準線から82.5㎜後方の点の集合線のうち、最も車両後方に位置する線

(b)　後方は、ＷＡＤが1,700㎜の点の集合線又はボンネット後部基準線から82.5㎜前方の点の集合線のうち、最も車両前方に位置する線

(c)　両側は、ボンネット側面基準線から82.5㎜内側の線

2.15.　「大人頭部インパクタ試験領域」とは、車両前部上面であり、次の境界で囲まれた領域をいう。なお、82.5㎜の距離はフレキシブルテープを車両外面に沿って緩みのない状態で設定するものとする。

(a)　前方は、ＷＡＤが1,700㎜の点の集合線又はボンネット・リーディング・エッジ基準線から82.5㎜後方の点の集合線のうち、最も車両後方に位置する線

(b)　後方は、ＷＡＤが2,100㎜の点の集合線又はボンネット後部基準線から82.5㎜前方の点の集合線のうち、最も車両前方に位置する線

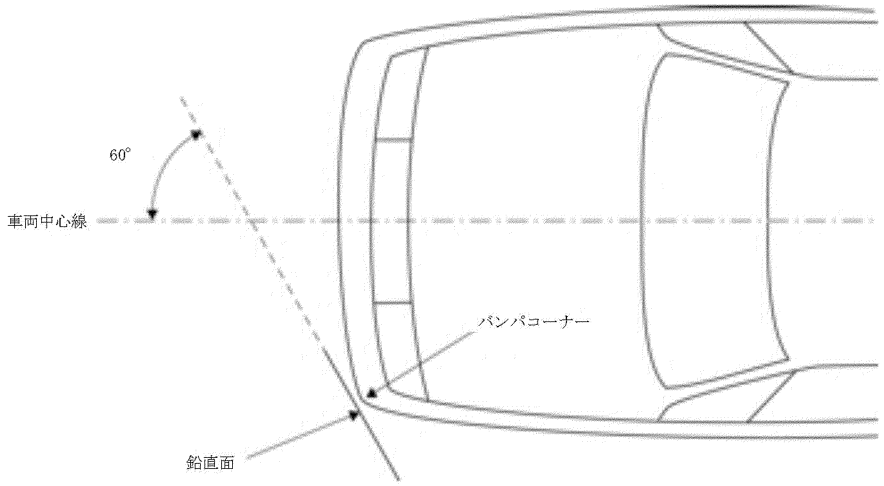
(c)　両側は、ボンネット側面基準線から82.5㎜内側の線

2.16.　「ボンネット上面試験領域」とは、2.14.及び2.15.にそれぞれ規定する子供頭部インパクタ試験領域と大人頭部インパクタ試験領域を合わせたものをいう。

2.17.　「バンパ」とは、車両の前面下部の表面構造（低速前面衝突時の車両保護用の全ての構造物及び付属物を含む。)であって、2.18.に規定する左右のバンパコーナーを通る２つの鉛直線、2.19.に規定するバンパ上部基準線及び2.20.に規定するバンパ下部基準線で囲まれる領域をいう。

2.18.　「バンパコーナー」とは、車両中心線と60°の角度をなして、バンパ表面と接する鉛直面との接点をいう（図６参照)。

図６　バンパコーナー



2.19.　「バンパ上部基準線」とは、歩行者がバンパと接触する点の上限を表し、700㎜の長さの直線を車両中心線と直交する鉛直面と平行な鉛直線から車両後方に20°傾け、地面とバンパ表面に接触させながら車両前面を左右に移動させたときの、直線とバンパとの最も高い接点の軌跡をいう（図７参照)。このとき、必要に応じて、直線を短くする等により、バンパより上の構造物との接触を避けるものとする。